



**关于北京某晶体技术股份有限公司收购美国公司 100%股权
项目尽职调查报告案例**

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 引言及释义

第一节 引言

第二节 释义

第二章 项目概况

第一节 项目背景

一、政策背景

（一）我国促进境外投资文件

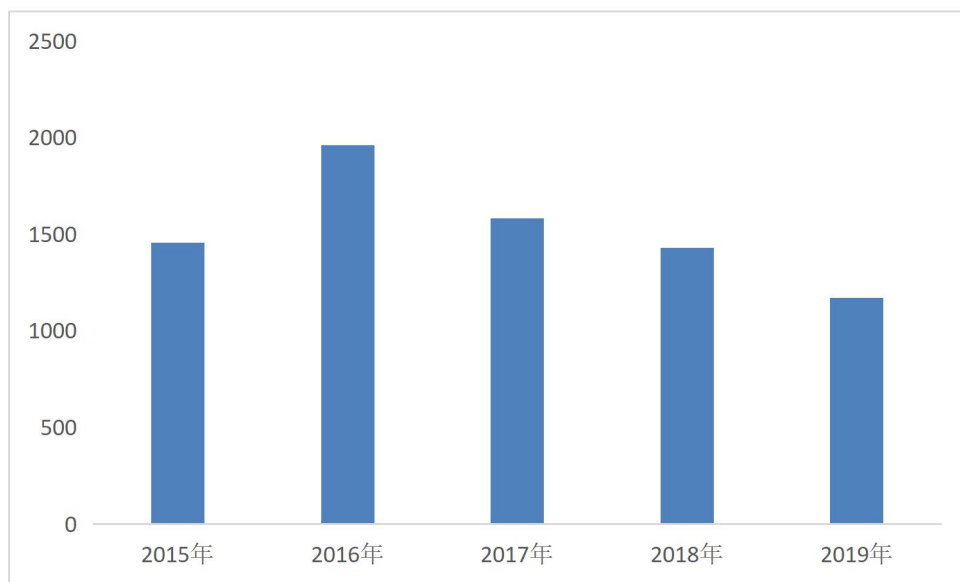
（二）美国投资政策环境

二、经济背景

（一）我国对外投资整体保持健康有序

党的十八大以来，中国对外投资合作稳步健康发展，规模不断扩大、结构不断优化、效益不断提升，2019年，中国对外投资合作面对国际国内新的复杂形势，整体保持健康有序发展，在投资地区分布、行业分布、投资结构、对“一带一路”合作、对外承包工程规模等领域呈现出新的发展动态。

图表 1：2015 年—2019 年我国境外投资规模



（二）收益再投资创历史新高

图表 2：2019 年中国非金融类对外直接投资构成

指标	金额（亿美元）	同比（%）	比重（%）	比重较上年
----	---------	-------	-------	-------

新增股权				
新增留存收益				
债务工具投资				

(三) 中国已成为美国前五大主要货物出口目的

图表 3：美国前五大货物出口地

三、项目发起的背景

第二节 项目概述

图表 4：项目实施进度表

第三章 投资主体基本情况

第一节 北京通美晶体技术股份有限公司基本情况

一、基本信息

图表 5：企业基本信息

企业名称	
统一社会信用代码	
住所	
法定代表人	
注册资本	
成立日期	
登记机关	
企业类型	
经营范围	
营业期限	

二、主要股东及股权结构

****股权结构具体情况如下：

图表 6：主要股东及股权结构

序号	股东名称	认购股份数(股)	出资方式	持股比例 (%)	出资时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

三、投资方基本经营情况

图表 7：截止 2020 年 12 月 31 日****经营情况

单位：元人民币

四、资产负债情况

图表 8：截至 2020 年 12 月 31 日***资产负债情况

单位：元人民币

五、公司行业竞争及地位

图表 9：公司及对标企业经营规模和行业地位

公司	参考市值 (截至 2021 年 2 月 8 日)	经营规模	主要产品及行业地位

第二节 或有事项

第三节 税务状况

第四章 项目收购方案

第一节 收购标的企业概况

一、基本信息

二、收购前股权结构

图表 10：收购前投资股权结构

序号		
1		

三、收购后股权结构

图表 11：收购后股权结构

序号	AXT 股权结构	股权占比
1		

四、基本经营情况

五、资产负债情况

六、税务状况及或有事项

第三节 收购方案

一、交易的定价政策和定价依据

二、实施主体

三、交易方案

四、收购进度安排

五、其他竞争者的应对设想

第四节 投资完成企业发展计划

第五节 相关配套条件落实情况

第五章 项目投资环境

第一节 项目所在国家与项目有关的法律法规

- 一、市场准入规定
- 二、投资方式的规定
- 三、优惠政策
- 四、在美国解决商务纠纷的主要途径
- 六、项目所在国家与项目有关的法律法规小结

第二节 税收体系

- 一、税收体系和制度
- 二、主要税赋和税率
- 三、税收体系小结

第三节 我国与美国的外交环境

第四节 项目市场环境分析

一、2020 年上半年，全球半导体产业市场规模为 2081.6 亿美元，同比增长 5.98%

根据世界半导体贸易统计(WSTS)数据，2011-2020 年全球半导体市场规模呈波动变化趋势，2017-2018 年连续两年保持高速增长后，受中美贸易问题、下游消费电子市场疲软等影响，2019 年全球半导体市场规模为 4123.07 亿美元，同比下降 12.05%，主要体现在存储芯片市场的下行。2020 年上半年，全球半导体产业市场规模为 2081.6 亿美元，同比增长 5.98%，疫情未对半导体产业产生显著影响。

- 二、半导体材料市场规模超 500 亿美元
- 三、2021 年全球半导体材料市场将可达到 565 亿美元
- 四、项目市场环境小结

在瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，加重了市

场的不确定性，能否把握市场命脉，抢占市场先机，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。

调查研究得出，半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。半导体材料市场可以分为前端晶圆制造材料和后端封装材料市场。半导体材料是现代集成电路产业的基础，是集成电路制造的物质载体，具有重要的战略意义。2019年0月初，工信部发布了《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函》，称下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。

近年来，云计算、物联网、5G、人工智能、车联网等新兴应用领域已进入了快速发展阶段。新兴应用领域的快速发展，对高端集成电路、功率器件、射频器件等产品的需求也持续增加，同时也驱动传感器、连接芯片、专用SoC等芯片技术的创新。另外，印度、东南亚、非洲等新兴市场的逐渐兴起，也为半导体行业行业发展提供了持续的动力。随着新领域、新应用的普及，新兴市场的发展，5至10年周期来看，半导体材料行业的未来市场前景乐观。

第五节 中央和地方政府及当地社区的意见

第六章 项目合作及资金情况

第一节 项目资金投入方案

第二节 项目投资资金运用

一、投资估算编制依据及说明

二、投资估算范围

三、投资估算的构成

图表 16：项目投资估算表

单位：美元

四、项目资金筹措及落实情况

第七章 项目经济及社会效益评价

第一节 经济效益评价

第二节 社会效益评价

第八章 风险对策与分析

第九章 项目尽调结论及建议

第一节 项目尽调结论

第二节 项目尽调建议

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806